

2014-2020年中国LED封装行业深度研究与投资前景调研报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2014-2020年中国LED封装行业深度研究与投资前景调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/1143821LQM.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

第一章 LED封装相关概述 15

1.1 LED封装简介 15

1.1.1 LED封装作用 15

1.1.2 LED封装的形式 17

1.1.3 LED封装的结构类型 18

1.1.4 LED封装的工艺流程 18

1.1.5 LED封装对封装材料要求 22

1.2 LED封装的常见要素 22

1.2.1 LED引脚成形方法 22

1.2.2 LED弯脚及切脚 22

1.2.3 LED清洗 23

1.2.4 LED过流保护 25

1.2.5 LED焊接条件 26

第二章 2013-2014年中国LED封装产业整体运营态势分析 28

2.1 2013-2014年世界LED封装业的发展总况 28

2.1.1 世界LED封装业发展规模及应用 28

2.1.2 世界LED封装企业分析 28

2.1.3 世界LED封装技术先进性分析 29

2.2 2013-2014年中国LED封装业的发展综述 29

2.2.1 中国LED封装业发展成果 29

2.2.2 产值增长情况 30

2.2.3 产量增长情况 30

2.2.4 价格分析 31

2.2.5 利好因素 31

2.3 2013-2014年国内重要LED封装项目的建设进展 31

2.3.1 韩企投资扬州兴建LED封装基地 31

2.3.2 西安经开区LED封装线项目投产 32

2.3.3 长治高科LED封装项目竣工投产 32

- 2.3.4 敬亭园中园LED支架及封装项目开建 33
- 2.3.5 源力光电LED封装线正式投产 33
- 2.4 SMD LED封装 34
 - 2.4.1 SMD LED封装市场发展简况 34
 - 2.4.2 SMD LED封装技术壁垒较高 35
 - 2.4.3 SMD LED封装产能尚未过剩 37
 - 2.4.4 SMD LED封装受益于芯片价格下降 40
- 2.5 2013-2014年中国LED封装业发展中存在的热点问题探讨 41
 - 2.5.1 制约我国LED封装业发展的因素 41
 - 2.5.2 国内LED封装企业面临的挑战 43
 - 2.5.3 封装业销售额与海外企业差距明显 44
 - 2.5.4 传统封装工艺成为系统成本瓶颈 45
- 2.6 促进中国LED封装业发展的策略 46
 - 2.6.1 做大做强LED封装产业的对策 46
 - 2.6.2 发展LED封装行业的措施建议 47
 - 2.6.3 LED封装业发展需加大研发投入 48
 - 2.6.4 我国LED封装业应向高端转型 49

第三章 2013-2014年中国LED封装市场新格局透析 50

- 3.1 2013-2014年中国LED封装市场发展态势 50
 - 3.1.1 中国成中低端LED封装重要基地 50
 - 3.1.2 国内LED封装企业发展不平衡 51
 - 3.1.3 中国LED封装市场缺乏大型企业 52
 - 3.1.4 LED产业上游厂商涉足封装市场 54
 - 3.1.5 台湾LED封装产能向大陆转移 55
- 3.2 中国LED封装企业分布状况 56
 - 3.2.1 2012年LED封装企业区域分布 56
 - 3.2.2 2012年LED封装企业区域分布 56
- 3.3 广东省LED封装业 60
 - 3.3.1 主要特点 60
 - 3.3.2 重点市场 61

3.3.3 发展趋势 62

第四章 2013-2014年中国LED封装行业技术研发进展状况 64

4.1 中外LED封装技术的差异 64

4.1.1 封装生产及测试设备差异 64

4.1.2 LED芯片差异 64

4.1.3 封装辅助材料差异 65

4.1.4 封装设计差异 65

4.1.5 封装工艺差异 66

4.1.6 LED器件性能差异 66

4.2 中国LED封装技术发展概况 68

4.2.1 封装技术影响LED产品可靠性 68

4.2.2 中国LED业专利集中在封装领域 69

4.2.3 中国LED封装业的技术特点 69

4.2.4 LED封装技术水平不断提升 70

4.2.5 LED封装业技术研发仍需加强 70

4.3 LED封装关键技术介绍 71

4.3.1 大功率LED封装的关键技术 71

4.3.2 显示屏用LED封装的技术要求 76

4.3.3 固态照明对LED封装的技术要求 80

第五章 2013-2014年中国LED封装设备及封装材料的发展 82

5.1 LED封装设备市场分析 82

5.1.1 我国LED封装设备市场概况 82

5.1.2 LED封装设备国产化亟需加速 83

5.1.3 发展我国LED封装设备业的思路 84

5.2 LED封装材料市场分析 85

5.2.1 LED封装主要原材介绍 85

5.2.2 我国LED封装材料市场简析 85

5.2.3 部分关键封装原材料仍依赖进口 86

5.2.4 LED封装用基板材料市场走向分析 86

5.3 LED封装支架市场 86

5.3.1 国内LED封装支架市场格局分析 86

5.3.2 LED封装支架技术未来发展趋势 87

5.3.3 我国LED封装支架市场前景广阔 88

第六章 2013-2014年中国LED封装产业竞争新形态分析 89

6.1 2013-2014年中国LED封装市场竞争格局 89

6.1.1 中国采购影响世界封装市场格局 89

6.1.2 我国LED封装市场各方力量简述 89

6.1.3 国内LED封装市场竞争加剧 90

6.1.4 本土LED封装企业整合步伐加速 91

6.2 2013-2014年中国LED封装企业竞争力简析 91

6.2.1 2013年本土封装企业竞争力排名 91

6.2.2 2013年本土LED封装企业竞争力排名 96

6.3 2014-2020年中国LED封装竞争趋势预测分析 99

第七章 2013-2014年全球LED封装顶尖企业分析 102

7.1 科锐 (CREE) 102

7.1.1 企业概况 102

7.1.2 企业LED封装运营态势 102

7.1.3 企业发展战略分析 102

7.2 日亚化学 (NICHIA) 103

7.2.1 企业概况 103

7.2.2 企业LED封装运营态势 103

7.2.3 企业发展战略分析 106

7.3 飞利浦 (Philips) 107

7.3.1 企业概况 107

7.3.2 企业LED封装运营态势 107

7.3.3 企业发展战略分析 109

- 7.4 三星LED (Samsung LED) 111
 - 7.4.1 企业概况 111
 - 7.4.2 企业LED封装运营态势 111
 - 7.4.3 企业发展战略分析 112
- 7.5 首尔半导体 (SSC) 112
 - 7.5.1 企业概况 112
 - 7.5.2 企业LED封装运营态势 113
 - 7.5.3 企业发展战略分析 114

第八章 2013-2014年中国台湾主要LED封装重点企业运营分析 116

- 8.1 亿光电子 116
 - 8.1.1 企业概况 116
 - 8.1.2 企业LED封装运营态势 116
 - 8.1.3 企业发展战略分析 118
- 8.2 光宝集团 119
 - 8.2.1 企业概况 119
 - 8.2.2 企业LED封装运营态势 120
 - 8.2.3 企业发展战略分析 120
- 8.3 东贝光电 122
 - 8.3.1 企业概况 122
 - 8.3.2 企业LED封装运营态势 122
 - 8.3.3 企业发展战略分析 123
- 8.4 宏齐科技 124
 - 8.4.1 企业概况 124
 - 8.4.2 企业LED封装运营态势 124
 - 8.4.3 企业发展战略分析 124
- 8.5 台积电 125
 - 8.5.1 企业概况 125
 - 8.5.2 企业LED封装运营态势 125
 - 8.5.3 企业发展战略分析 126
- 8.6 艾笛森 128

- 8.6.1 企业概况 128
- 8.6.2 企业LED封装运营态势 129
- 8.6.3 企业发展战略分析 129

第九章 2013-2014年中国内地主要LED封装重点企业 130

- 9.1 国星光电(002449) 130
 - 9.1.1 企业概况 130
 - 9.1.2 企业主要经济指标分析 130
 - 9.1.3 企业盈利能力分析 135
 - 9.1.4 企业偿债能力分析 135
 - 9.1.5 企业运营能力分析 136
 - 9.1.6 企业成长能力分析 136
- 9.2 雷曼光电 137
 - 9.1.1 企业概况 137
 - 9.1.2 企业LED封装运营态势 143
 - 9.1.3 企业发展战略分析 144
- 9.3 鸿利光电 144
 - 9.1.1 企业概况 144
 - 9.1.2 企业LED封装运营态势 149
 - 9.1.3 企业发展战略分析 150
- 9.4 大族光电(002008) 150
 - 9.4.1 企业概况 150
 - 9.4.2 企业主要经济指标分析 150
 - 9.4.3 企业盈利能力分析 154
 - 9.4.4 企业偿债能力分析 154
 - 9.4.5 企业运营能力分析 155
 - 9.4.6 企业成长能力分析 155
- 9.5 深圳市瑞丰光电子有限公司 156
 - 9.5.1 企业概况 156
 - 9.5.2 企业主要经济指标分析 157
 - 9.5.3 企业盈利能力分析 157

- 9.5.4 企业偿债能力分析 158
- 9.5.5 企业运营能力分析 160
- 9.5.6 企业成长能力分析 163
- 9.6 宁波升谱光电半导体有限公司 164
 - 9.6.1 企业概况 164
 - 9.6.2 企业主要经济指标分析 164
 - 9.6.3 企业盈利能力分析 165
 - 9.6.4 企业偿债能力分析 166
 - 9.6.5 企业运营能力分析 168
 - 9.6.6 企业成长能力分析 171
- 9.7 南京汉德森科技股份有限公司 171
 - 9.7.1 企业概况 171
 - 9.7.2 企业主要经济指标分析 171
 - 9.7.3 企业盈利能力分析 172
 - 9.7.4 企业偿债能力分析 173
 - 9.7.5 企业运营能力分析 175
 - 9.7.6 企业成长能力分析 178

第十章 2014-2020年中国LED封装产业发展趋势及前景 179

- 10.1 2014-2020年LED封装产业未来发展趋势 179
 - 10.1.1 功率型白光LED封装技术发展趋势 179
 - 10.1.2 LED封装技术将向模块化方向发展 181
 - 10.1.3 LED封装产业未来发展走向分析 182
- 10.2 2014-2020年中国LED封装市场前景展望 183
 - 10.2.1 我国LED封装市场发展前景乐观 183
 - 10.2.2 LED封装产品应用市场将持续扩张 183
 - 10.2.3 中国LED通用照明封装市场规模预测 184

第十一章 2014-2020年中国LED封装产业投资前景预测 185

- 11.1 2014-2020年中国LED封装行业投资概况 185

11.1.1	LED封装行业投资特性	185
11.1.2	LED封装具有良好的投资价值	189
11.1.3	LED封装投资环境利好	189
11.2	2014-2020年中国LED封装投资机会分析	190
11.2.1	LED封装投资热点（LED照明、LED照明电视）	190
11.2.2	国家节能减排衍生LED封装投资机会	191
11.3	2014-2020年中国LED封装投资风险及防范	192
11.3.1	技术风险分析	192
11.3.2	金融风险分析	193
11.3.3	政策风险分析	194
11.3.4	竞争风险分析	195
11.4	专家建议	196

图表目录

图表 1	2009-2010年台湾、大陆主要SMD LED企业产能对比	35
图表 2	2010年中国大陆SMD LED主要厂商的扩产情况	37
图表 3	2010年在大陆扩产的主要港台企业	39
图表 4	国星光电LED芯片单价变动对LED封装产品毛利的影响	40
图表 5	2010-2011年台湾前8大LED封装厂SMD产能及大陆业务	55
图表 6	2010年台湾在大陆投资的LED封装项目	55
图表 7	2012年全国LED封装企业区域分布	56
图表 8	2013年中国LED封装企业竞争力排名	96
图表 9	国星光电主要经济指标分析	132
图表 10	国星光电盈利能力分析	135
图表 11	国星光电偿债能力分析	135
图表 12	国星光电运营能力分析	136
图表 13	国星光电成长能力分析	136
图表 14	雷曼光电主要财务指标分析	138
图表 15	雷曼光电主要经济指标分析	139
图表 16	鸿利光电主要财务指标分析	145
图表 17	鸿利光电主要经济指标分析	146
图表 18	大族光电主要经济指标分析	150

图表 19	大族光电盈利能力分析	154
图表 20	大族光电偿债能力分析	154
图表 21	大族光电运营能力分析	155
图表 22	大族光电成长能力分析	155
图表 23	近3年深圳市瑞丰光电子有限公司销售毛利率变化情况	157
图表 24	近3年深圳市瑞丰光电子有限公司资产负债率变化情况	159
图表 25	近3年深圳市瑞丰光电子有限公司产权比率变化情况	159
图表 26	近3年深圳市瑞丰光电子有限公司固定资产周转次数情况	160
图表 27	近3年深圳市瑞丰光电子有限公司流动资产周转次数变化情况	161
图表 28	近3年深圳市瑞丰光电子有限公司总资产周转次数变化情况	162
图表 29	近3年宁波升谱光电半导体有限公司销售毛利率变化情况	165
图表 30	近3年宁波升谱光电半导体有限公司资产负债率变化情况	166
图表 31	近3年宁波升谱光电半导体有限公司产权比率变化情况	167
图表 32	近3年宁波升谱光电半导体有限公司固定资产周转次数情况	168
图表 33	近3年宁波升谱光电半导体有限公司流动资产周转次数变化情况	169
图表 34	近3年宁波升谱光电半导体有限公司总资产周转次数变化情况	170
图表 35	近3年南京汉德森科技股份有限公司销售毛利率变化情况	172
图表 36	近3年南京汉德森科技股份有限公司资产负债率变化情况	173
图表 37	近3年南京汉德森科技股份有限公司产权比率变化情况	174
图表 38	近3年南京汉德森科技股份有限公司固定资产周转次数情况	175
图表 39	近3年南京汉德森科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况	176
图表 40	近3年南京汉德森科技股份有限公司总资产周转次数变化情况	177

表格目录

表格 1	近4年深圳市瑞丰光电子有限公司销售毛利率变化情况	157
表格 2	近4年深圳市瑞丰光电子有限公司资产负债率变化情况	158
表格 3	近4年深圳市瑞丰光电子有限公司产权比率变化情况	159
表格 4	近4年深圳市瑞丰光电子有限公司固定资产周转次数情况	160
表格 5	近4年深圳市瑞丰光电子有限公司流动资产周转次数变化情况	161
表格 6	近4年深圳市瑞丰光电子有限公司总资产周转次数变化情况	162
表格 7	近4年宁波升谱光电半导体有限公司销售毛利率变化情况	165
表格 8	近4年宁波升谱光电半导体有限公司资产负债率变化情况	166

- 表格 9 近4年宁波升谱光电半导体有限公司产权比率变化情况 167
- 表格 10 近4年宁波升谱光电半导体有限公司固定资产周转次数情况 168
- 表格 11 近4年宁波升谱光电半导体有限公司流动资产周转次数变化情况 169
- 表格 12 近4年宁波升谱光电半导体有限公司总资产周转次数变化情况 170
- 表格 13 近4年南京汉德森科技股份有限公司销售毛利率变化情况 172
- 表格 14 近4年南京汉德森科技股份有限公司资产负债率变化情况 173
- 表格 15 近4年南京汉德森科技股份有限公司产权比率变化情况 174
- 表格 16 近4年南京汉德森科技股份有限公司固定资产周转次数情况 175
- 表格 17 近4年南京汉德森科技股份有限公司流动资产周转次数变化情况 176
- 表格 18 近4年南京汉德森科技股份有限公司总资产周转次数变化情况 177

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/1143821LQM.html>